

WSM-200

ウェーハ / 支持基板貼付装置

WAFER/SUBSTRATE DETACHING MACHINE

WITH MOUNTING FUNCTION

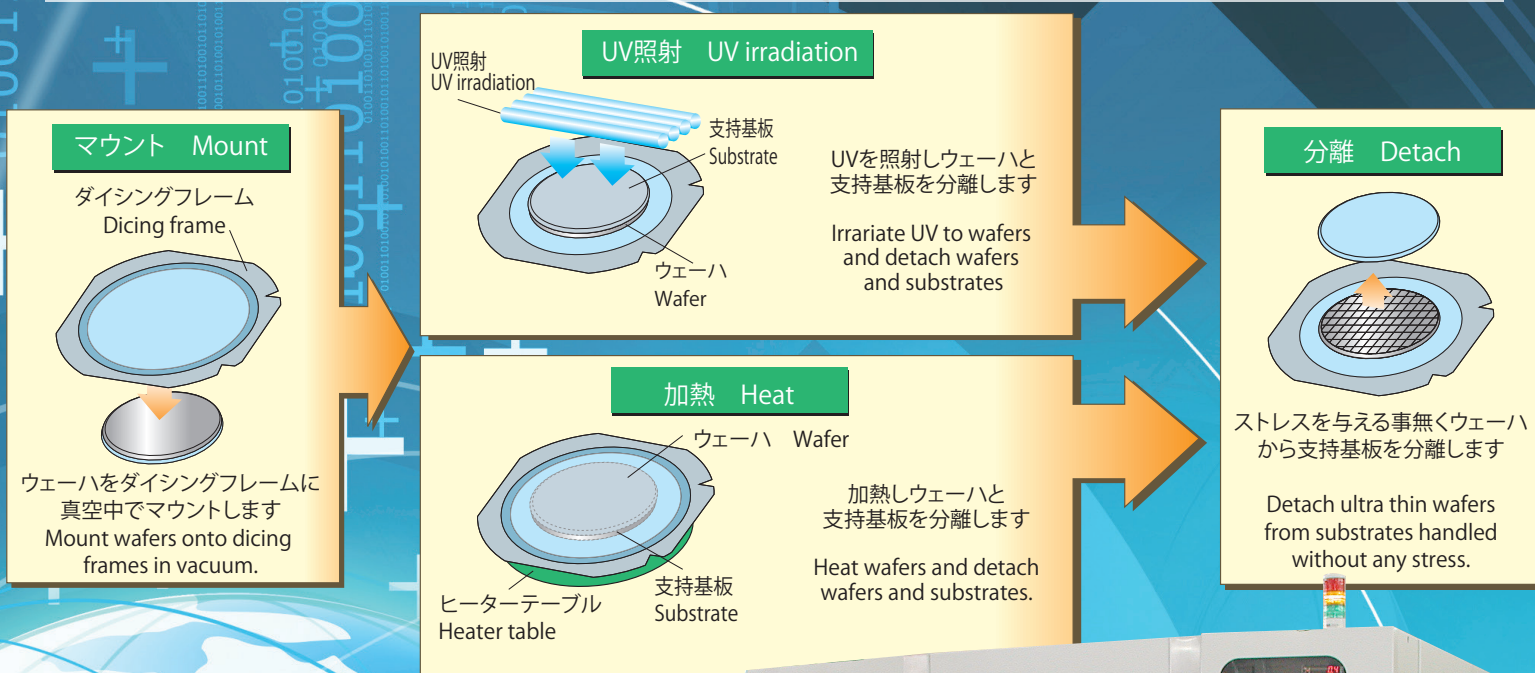
【概要 - Outline -】

◆本装置は、支持基板に貼付けられたウェーハを真空チャンバー内でマウントし、UV 照射盤極薄（又は加熱）後、

This machine mounts wafers which are attached with substrate in vacuum chamber, then irradiate UV, then detach wafers and substrates.

支持基板の分離を行います。超薄厚ウェーハのハンドリング及びマウントはタカトリ独自の吸着エレメント、真空チャンバーの
No stress to wafers by Takatori unique thin wafer handling, vacuum element, vacuum chamber.

採用によりウェーハにストレスを与えません。



仕様 Specification	WSM-200
スループット Throughput	40 枚 /h (ご使用条件により異なります Depend on data setting)
対応ウェーハサイズ Wafer Size	6・8 inch
装置寸法 Demension	W 1,800× D 1,800 × H 1,800 mm
重量 Weight	1,100 kg (UV200kgg 含む Incl. 200kg UV)

※ 外観・仕様は改良の為、予告なく変更する場合があります。
System appearance and specifications are subject to change without prior notice from the supplier.